

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2005年2月24日 (24.02.2005)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2005/017984 A1

(51)国際特許分類:

H01L 21/02

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/011836

(22)国際出願日: 2004年8月18日 (18.08.2004)

(25)国際出願の言語:

日本語

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願2003-294425 2003年8月18日 (18.08.2003) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP). 住友電気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5410041

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 Osaka (JP).

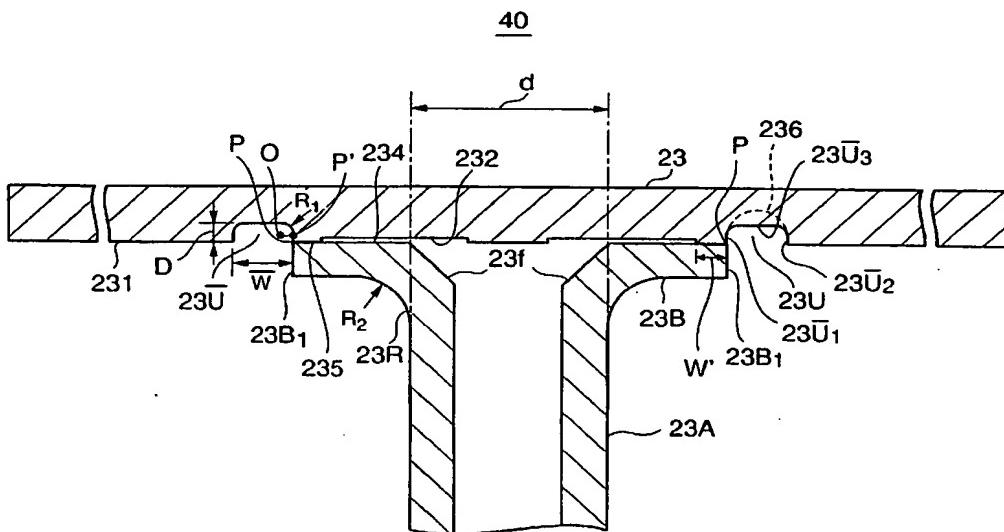
(72)発明者: および

発明者/出願人(米国についてのみ): 田中澄 (TANAKA, Sumi) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650番地 東京エレクトロンAT株式会社内 Yamanashi (JP). 斎藤哲也 (SAITO, Tetsuya) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650番地 東京エレクトロンAT株式会社内 Yamanashi (JP). 夏原益宏 (NATSUHARA, Masahiro) [JP/JP]; 〒6648611 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1 住友電気工業株式会社 伊丹製作所内 Hyogo (JP). 仲田博彦 (NAKATA, Hirohiko) [JP/JP]; 〒6648611 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1 住友電気工業株式会社 伊丹製作所内 Hyogo (JP).

[続葉有]

(54)Title: SUBSTRATE HOLDING STRUCTURE AND SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54)発明の名称: 基板保持構造物および基板処理装置



WO 2005/017984 A1

(57)Abstract: An object of the invention is to suppress thermal stress breakage of a substrate holding platform in a substrate holding structure for holding a processing subject substrate. In a board holding structure provided with a board holding platform at the front end of a pillar, a joining section between the pillar and the substrate holding platform is formed with a flange defined by the inner and outer peripheral surfaces, in which case the inner peripheral surface is formed of an inclined surface in which the inner diameter of the flange continuously increases toward the lower surface of the substrate holding platform. Further, the lower surface of the substrate holding platform to which the flange is joined is formed with a U-shaped groove corresponding to the outer peripheral surface of the flange.

(57)要約: 本発明は、被処理基板を保持する基板保持構造物において、基板保持台の熱応力による破損を抑制することを目的としている。支柱先端部に基板保

[続葉有]